산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2023. 8. 29.(화) 11:00 < 8. 30.(수) 조간 > 배포 2023. 8. 29.(화)

반도체 첨단 패키징 선도기술 확보를 위한 민관 공동협력 체계구축

- 반도체 첨단 패키징, 대규모 연구개발(R&D) 추진을 위한 업무협약(MOU) 체결

산업통상자원부(장관 이창양) 주영준 산업정책실장은 반도체 첨단 패키징 산업 경쟁력 확보를 위한 민관 협력 반도체 첨단 패키징 기술개발을 위해 8. 29.(화) 서울 엘타워에서 업무 협약식을 개최했다.

이날 행사에는 반도체 수요기업인 삼성전자, SK하이닉스와 소재·부품·장비, 반도체 후공정 전문업체(OSAT) 및 반도체 설계 전문(팹리스) 기업 등이 참여하여 「반도체 첨단 패키징 기술개발 협력에 관한 협약」을 체결하였고, 반도체 첨단 패키징 선도기술 확보를 위한 적극적인 상호 협력과 첨단 패키징 선순환 생태계 구축을 통한 반도체 후공정 산업 육성 등을 위해 적극적으로 협조해 나가기로 하였다.

* 서명 : 산업부, 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 하나마이크론, 프로텍, 사피온코리아, 심텍, 차세대지능형반도체사업단, 한국반도체산업협회, 한국산업기술평가관리원

첨단 패키징은 디지털 전환에 따른 저전력·고성능을 구현하기 위한 다기능·고집적 반도체의 수요증가로, 반도체 공정 미세화 기술의 한계 극복 및 개별 소자들의 단일 패키지화 필요성 증가에 따라 핵심 기술로 부상하였다.

산업부는 변화하는 패키징 시장의 적기 진입을 위해 첨단 패키징 관련 신규 연구개발(R&D)을 추진하고 있으며, 세계(글로벌) 반도체 첨단 패키징 산업의 기술 주도권 확보를 통한 시스템반도체 산업의 수준 향상(레벨업)을 위해 산학연 전문가들과 함께 '반도체 첨단 패키징 선도기술 개발'을 위한 대규모 연구개발(R&D) 사업을 준비하고 있다. 반도체 위탁생산(파운드리) 및 종합반도체업체(IDM) 등 기업의 수요를 적극적으로 반영하여 고집적·고기능·저전력 첨단 패키징 초격차 기술개발, 국내 소재·부품·장비와 반도체 후공정(OSAT) 기업의 핵심 기술 확보, 차세대 기술 선점을 위한 미·유럽연합(EU) 등 반도체 전문 연구기관 및 세계(글로벌) 반도체 후공정(OSAT) 기업과의 협업 체계구축 등의 사업을 추진할 예정이다.

주영준 산업정책실장은 "세계적(글로벌) 반도체 첨단 패키징 선도기술 확보를 위해 기업들의 적극적인 기술개발 협력 및 과감한 투자를 요청한다." 라고 당부하며, "정부도 업계의 노력에 발맞춰 반도체 패키징 기술 경쟁력 강화 및 견고한 생태계 조성을 위해 지원과 협력을 아끼지 않겠다" 라고 밝혔다.

담당 부서	첨단산업정책국 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	라정인 (044-203-4276)

新성장 4.0 대한민국 정책브리핑 OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 **반도체 첨단 패키징 선도기술개발을 위한 MOU 체결 계획(안)**

□ 행사 개요

○ **(목적)** 반도체 **첨단 패키징 경쟁력 확보**를 위한 반도체 후공정 생태계 구축을 위해 **민·관 기술개발** 협력 **MOU 체결**

○ **(일시/장소)** '23.8.29(화) 14:00~15:30 / 양재 엘타워 벨론홀(5층)

○ **(참석자)** 산업부, 소자·소부장·OSAT 기업 등 산학연 관계자 30여명

○ **(주요내용)** ①**MOU 체결***, ②사업소개, ③**패널토의****

* 업계 7명(소자, 소부장 및 OSAT 기업), 사업단 1명, 협회 1명, 전담기관 1명 등 총 10명

** 주제 : **미래 반도체 산업의 첨단 패키징 중요성 및 기술개발 생태계 변화**
참석자 : 김성동 교수(좌장), 최광성 박사(ETRI), 이광주 연구위원(LG화학), 이규진 상무(심텍)

□ 세부 진행 계획

일정		주요내용	비고
14:00~14:05	(5')	행사 개회 및 내빈 소개	사회자
14:05~14:10	(5')	모두발언	산업부
14:10~14:20	(10')	MOU 체결 및 기념촬영	-
14:20~14:40	(20')	2023년 첨단 패키징 기술 및 산업	현대차증권
14:40~14:50	(10')	'반도체 첨단패키징 선도기술개발사업' 소개	위원장
14:50~15:30	(40')	전문가 의견 수렴 및 토론	산·학·연 전문가
-	-	결과정리 및 폐회	사회자